

亞洲各國半導體包裝公司之動向

/ 陳耀聰

國 別	公 司 名 稱	產 量 (相當於14-16支腳)	員 工 人 數	最大之 腳 數	包 裝 形 式 *
香 港	Semiconductor Devices	NA	900	156	1-4, 6, 12, 13, 15
香 港	Swire Technologies	200 M	200	256	1, 3-4, 7-8, 11-13
韓 國	Anam Industrial (安南)	2.2 B	NA	NA	1-1
韓 國	Hyundai Electronics (現代電子)	300 M	4,040	68	2-4, 7-8, 10-15
韓 國	U-Jin Electronics	39 M	60	NA	N.A
菲 律 賓	Asionics Philipines	30 M	200	48	1, 5-7, 14a
菲 律 賓	Cirtek Electronics	30 M	180	40	7-8, 11-12
菲 律 賓	Dynetics	280 M	1,700	84	1-4, 6-7, 11-13
菲 律 賓	Filipines Micro-Circuits	80 M	1,300	40	1-8, 11-14b
菲 律 賓	Integrated Microelectronics	150 M	1,760	84	1-4, 7, 11-14
菲 律 賓	Labtech Manufacturing	NA	321	10	N.A
菲 律 賓	Semiconductor Devices	120 M	2,700	64	1-4, 6-9, 11-14
泰 國	Chinteik Electronic	60 M	450	68	4, 8-9, 11-13
泰 國	Hana Semiconductor (BKK)	130 M	483	68	1-2, 7-8, 11, 14g
新 加 坡	Team Semiconductor	200 M	NA	300	1-14f, 14h, 15

資料來源：1986. 6月 Semiconductor International.

註：* 包裝形式：

1-hybrid	10-other power types	14e-TO-237
2-chip-on-board	12-quad	14f-flat pack
3-pin grid array	13-sidebrazed	14g-watch modules
4-CERDIP	14-other	14h-microwave
6-metal can	14a-opto	15-custom
7-plastic DIP	14b-24 lead skinny	16-manufacturer of bridge
8-SOIC	14c-ceramic chip carriers	diodes & rectifiers
9-TO-220	14d-TO-92	